# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-270926

(43) Date of publication of application: 20.09.2002

(51)Int.CI.

H01S 3/094

H01S 3/00

(21)Application number: 2001-063331

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

07.03.2001

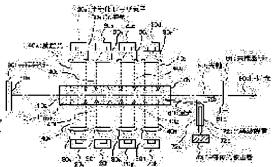
(72)Inventor: TSUNEKANE MASAKI

**MUKOHARA KATSUHARU** 

# (54) LD-PUMPED SOLID-STATE LASER AND METHOD OF DIAGNOSING ITS STATE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly reliable LD-pumped solid-state laser from which the degree of deterioration of an LD(laser diode) can be grasped always accurately, and to provide a simple method by which the excited degree of a solid-state laser medium can be corrected and adjusted in accordance with the deteriorated degree of the LD.

SOLUTION: This LD-pumped solid-state laser has at least a laser rod 10, semiconductor laser elements 20a-20h which generate exciting light rays, an optical means, such as a reflecting mirror, optical waveguide medium 72, etc., provided near the optical axis of this laser in a laser resonator so that the means does not intercept the optical axis, and a photodetector 70 which detects fluorescence 60. The deteriorated state of the LD is always diagnosed by detecting the quantity of the fluorescence 60 generated from a solid-state laser medium by means of a photodetecting means and comparing the detected quantity with a preset value or premeasured value.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

15.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

3/094

3/00

# 四公外開特許公報(A)

(11)转許出顧公開番号 特期2002-270926 (P2002-270926A)

(43)公開日 平成14年9月20日(2008.9.20)

(51) Int.CL\* H015

識別記号

FΙ

HOIS 3/00

ターマコード(参考) G 5 F D 7 2

3/094

8

#### 李安静设 有 前沢項の数31 OL (全 19 頁)

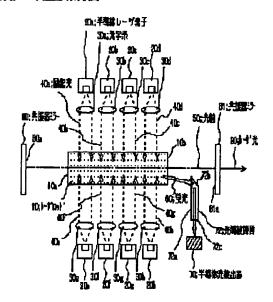
(21)出席番号	<b>\$\$\$</b> \$	(71) 出版人 000004237
A=1 bredisting -1	7140	日本電気機式会社
(22) 出 <b>期</b> 日	平成19年8月7日(2001.8.7)	東京都地区芝五丁目7番1号
		(72) 発明者 常包 正樹
		東京都灣区芝五丁目7番1号 日本電気機式金牡内
	•	(72) 發明者 內原 党治
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内
		(74) 代理人 100114872
		<b>弁理士 宮本 息可</b>
		Pターム(参考) BF072 AB02 AX01 1105 BX05 XX26
		10030 PP07

# (54) 【発明の名称】 半等体レーザ励起団体レーザ結晶及び被装置の状態診察方法

# (57)【要約】

[課題] 半導体レーザの劣化の度合いを常時、正確に把 握することができる信頼性の高い半導体レーザ励起固体 レーザ装置の提供、及び、劣化したLDの度合いに応じ て固体レーザ媒質への励起の度合いを補正、調整するた めの簡便な方法の提供。

【解決手段】 レーザロッド10と、励起光を発生する半 等体レーザ素子20a~20hと、レーザ共振器内のレ - ザ光铀の近傍かつ光铀を遮らない位置に設けた反射ミ ラー、光導波媒質72等の光学的手段と、蛍光6日を検 出する光検出器プロとを少なくとも有し、固体レーザ媒 質から発生する蛍光の量を光検出手段で検出し、その蛍 光量と子の定めた値又は子の測定した値とを比較するこ とによって、半導体レーザ光源の劣化状況を常時診断す る.



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】励起光を吸収し所定の波長の光を発生あるいは増幅する固体レーザ解質と、前記励起光を発生しかつ発生した励起光を直接、あるいは光学素子を介して該レーザ解質に導入する半導体レーザ光源とを少なくとも有する固体レーザ装置において、

該固体レーザ装置を構成するレーザ共振器内の、該共振 器内で発生するレーザ発振光の光軸の近傍かつ光軸を遮 らない位置に、該固体レーザ越質から発生する蛍光の量 を検出する蛍光検出手段を備えたことを特徴とする半導 体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項2】前記励起光が、前記レーザ発振光の光軸に対して時直交する方向から導入されることを特徴とする 請求項1記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項3】前記蛍光検出手段が、前記レーザ発振光の 光铀の近傍かつ光铀を遮らない位置に配設された光学的 手段と、前記光学的手段に築かれた前記蛍光を検出する 光検出器とからなることを特徴とする請求項1又は2に 記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項4】前記光学的手段が、該固体レーザ媒質から発せられた前記蛍光を反射させるミラーを含み、該ミラーに反射された前記蛍光が、空間伝搬して所定の位置に配設された前記光検出器に入射することを特徴とする請求項3記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項5】前記ミラーがパラボラ型形状に形成され、該ミラーに反射された前記蛍光が、空間伝搬して前記光 快出器に集光することを特徴とする請求項4記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 6】前記光学的手段が、前記蛍光の波長において透明な線質を備え、該線質の一端から入射した前記蛍光が、該線質内部を伝播して他端に配設された前記光検出器に入射することを特徴とする請求項 3記載の半導体レーザ励起圏体レーザ装置。

【請求項7】前記光学的手段が、前記レーザ発振光の光路の一部において光軸の周囲を取り囲むように形成され、前記光学的手段に設けた開口の端部から入射した前記蛍光が、外周側端部の所定の位置に配設された前記光検出器に導かれることを特徴とする請求項6記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項 8】前記光学的手段が、円板形状、多角形形状 又は楕円形状をなすことを特徴とする請求項7記載の半 築体レーザ励起圏体レーザ装置。

【請求項9】前記権円形状の第1の焦点に前記開口の中心が配置され、第2の焦点に前記光検出器が配置されていることを特徴とする請求項8記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項10】前記光学的手段の外周のうち、前記光検 出器近傍を除く領域に前記蛍光を反射する反射手段を備 え、前記開口側端部から入射した前記蛍光が前記反射手 段によって反射されて前記光検出器に導かれることを特 徴とする請求項7乃至9に記載の半導体レーザ励起固体 レーザ装置。

【請求項11】前記光検出器が、前記光学的手段の外周 全周にわたって複数配設され、該複数の光検出器の出力 を比較することにより、前記レーザ光の軸対象性又は劣 化した前記半導体レーザ光源の特定が行われることを特 数とする請求項7又は8に記載の半導体レーザ励起固体 レーザ装置。

【請求項12】前記開口が、前記レーザ課度の径よりも 小さく設定されていることを特徴とする請求項7.乃至 1 1のいずれかーに記載の半導体レーザ励起レーザ装置。 【請求項13】前記透明な媒質が、ガラスを母材として

(請水場)3)前に透明な残貨が、カラスを受けとして 形成されていることを特徴とする請求項6万至12のい ずれかーに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項14】前記遠明な媒質が、前記励起光の波長の 光を選択的に演奏させる材料、又は、レーザ発振に利用 されない蛍光の輝線スペクトルの波長を選択的に遠過す る材料で形成されていることを特徴とする請求項6万至 13のいずれかーに記載の半導体レーザ励起固体レーザ 装備。

【請求項15】前記光検出器に到達する前記蛍光の光路上に、前記励起光の波長の光を選択的に減衰させるフィルターを備えることを特徴とする請求項1乃至14のいずれかーに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項16】前記光検出器に到達する前記蛍光の光路上に、前記固体レーザ就質から発せられる前記蛍光のうち、レーザ発振に利用されない蛍光の超線スペクトルの波長を選択的に透過するフィルターを備えることを特徴とする請求項1乃至15のいずれかーに記載の半塔体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項17】前記半導体レーザ光源が、複数の半導体レーザ素子と、該複数の半導体レーザ素子を所定数のグループに分けて駆動する電源と、前記電源の駆動電流を制御する制御手段とを含み、前記光検出器で検出される前記蛍光の強度に応じて、前記グループごとの駆動電流が前記制御手段によって調整されることを特徴とする諸求項1乃至16のいずれかーに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置。

【請求項18】励起光を吸収し所定の波長の光を発生あるいは増幅する固体レーザ媒質と、前記励起光を発生しかつ発生した励起光を直接、あるいは光学素子を介して該レーザ媒質に導入する半導体レーザ光源と、該固体レーザ装置を構成するレーザ共振器内の、該共振器内で発生するレーザ発振光の光軸の近傍かつ光軸を連らない位置に設けられた蛍光検出手段とを少なくとも有する固体レーザ装置の状態診断方法であって、

該固体レーザ媒質から発生する蛍光の量を耐配蛍光検出 手段で検出し、前記蛍光の量と予め定めた値又は予め測 定した値とを比較することによって、前記半導体レーザ 光速の劣化状況を診断することを特徴とする半導体レー **ザ励起固体レーザ装置の診断方法。** 

【請求項19】前記螢光検出手段が、前記レーザ発接光の光軸の近傍かつ光軸を連らない位置に配設された光学的手段と、前記光学的手段に築かれた前記蛍光を検出する光検出器とからなることを特徴とする請求項18記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項20】前記光学的手段が、該固体レーザ媒質から発せられた前記蛍光を反射させるミラーを含み、該ミラーで反射した前記蛍光を、空間伝操させて所定の位置に配設した前記光快出器に入射させることを特徴とする請求項18又は19に記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項21】前記ミラーをパラボラ型形状に形成し、該ミラーで反射した前記蛍光を、空間伝掘させて前記光検出器に集光させることを特徴とする請求項20記載の半築体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項22】前記光学的手段が、前記強光の波長において透明な媒質を備え、該媒質の一端から入射した前記 敏光を、該媒質内部を伝播させて他端に配設した前記光 検出器に入射させることを特徴とする請求項18又は1 9に記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方

【請求項23】前記光学的手段を、前記レーザ発短光の 光路の一部において光軸の周囲を取り囲むように形成 し、前記光学的手段に設けた開口の場部から入射した前 記蛍光を、外周側場部の所定の位置に配設した前記光検 出器に築くことを特徴とする請求項22記載の半導体レ ーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項24】前記光学的手段が、円板形状、多角形形状又は楕円形状をなすことを特徴とする請求項23記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項25】前記格円形状の第1の焦点に前記開口の中心を配置し、第2の焦点に前記光検出器を配置することを特徴とする請求項24記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【諸求項25】前記光学的手段の外周のうち、前記光検 出器近傍を除く領域に前記蛍光を反射する反射手段を備 え、前記開口側端部から入射した前記蛍光を前記反射手 段によって反射して前記光検出器に導くことを特徴とす る請求項23乃至25のいずれかーに記載の半導体レー ザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項27】前記光検出器を、前記光学的手段の外周全周にわたって複数配設し、該複数の光検出器の出力を比較することにより、前記レーザ光の軸対象性又は劣化した前記半導体レーザ光源の特定を行うことを特徴とする請求項23又は24に記載の半導体レーザ励起圏体レーザ装置の診断方法。

【請求項28】前記開口を、前記レーザ媒質の後よりも小さく設定し、広がり角の大きいレーザビームを前記媒質により抑制することにより、前記レーザ光の広がり角

を制御することを特徴とする請求項23乃至27のいず れかーに記載の半導体レーザ励起レーザ装置の診断方 \*\*

【諸求項29】前記光検出器に到達する前記強光の光路上に、前記励起光の波長の光を選択的に減衰させるフィルター、又は、前記固体レーザ線質から発せられる前記強光のうち、レーザ発振に利用されない強光の輝線スペクトルの波長を選択的に遠避するフィルターの少なくとも一方を備えることを特徴とする請求項18乃至28のいずれかーに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

【請求項30】前記途明な媒質が、前記励起光の波長の 光を選択的に減衰させる材料、又は、レーザ発振に利用 されない蛍光の輝線スペクトルの波長を選択的に遠過す る材料で形成されていることを特徴とする請求項18乃 至28のいずれかーに記載の半導体レーザ励起固体レー ザ装置の診断方法。

【請求項31】前記半導体レーザ光源が、複数の半導体レーザ素子と、該複数の半導体レーザ素子を所定数のグループに分けて駆動する電源と、前記電源の駆動電流を制御する制御手段とを含み、前記光検出器で検出される蛍光の強度に応じて、前記グループごとの駆動電流を前記制御手段によって調整することを特徴とする請求項18乃至30のいずれかーに記載の半導体レーザ励起固体レーザ装置の診断方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体レーザ励起 固体レーザ装置及び該装置の状態診断方法に関し、特 に、半導体レーザの劣化診断を簡便かつ容易に行うこと ができる信頼性の高い半導体レーザ励起固体レーザ装置 及び該装置の状態診断方法に関する。

# [0002]

【従来の技術】Nd:YAGをはじめとする国体レーザ 雑質の光による励起方式として、ランプに比べレーザ雑 質への吸収効率が高く、小型・高効率・長寿命の半導体 レーザダイオード(以下LDと記す)を励起光源とす る、いわゆるLD励起国体レーザが近年注目されてい る。特に近年、1つの共振器内に数百個のLDを用いて キロワットにいたるレーザ出力を放出するLD励起国体 レーザ装置も開発されている。

【0003】 L Dはランプに比べ10倍以上寿命が長く、連続して10、000時間程度使用できるといわれている。しかしながらこの時間は平均的なもので、個々のLDでは数千時間程度で出力が低下するものも退在しており、初期的なLDの選別でそれらを完全に認識、取り除くことは困難である。また、L Dは固体レーザ装置に実装された状態においても、静電気や電源からの電気的なサージ、戻り光、埃やガス、結論などの外乱や外部環境によっても寿命が著しく短くなるために、レーザ装

置の信頼性向上、早期の故時対応には何らかの手段によってしからの励起光の光量を検出し、その劣化の度合いを把握する必要がある。

【0004】そこで、10W以下の低出力動作用しDでは、通常しDチップの出射面(前面)の反対側の高反射面(表面)からわずかに漏れる励起光を、LDパッケージ内に配設した光検出器でエネルギーを検出して励起光度の制御或いはLDの劣化検出に利用している。

【0005】また、従来より固体レーザ共振器を構成する出力ミラーから共振器の外部へ出射されるレーザ発振光を一部分岐したり、出力ミラー以外のミラーから漏れ出る発振光のエネルギーを光検出器で測定することで、レーザ出力の制御や LDの劣化検出に用いる方法も用いられている。

【0006】また、蛍光強度あるいは蛍光分布をレーザ発振光軸に沿った方向あるいはその延長線上で検出する方法も提案されている。図15、図16は、特開2000-269576号公報に記載されている実施例であり、固体レーザロッドからレーザ発振光軸に沿って出射された蛍光をモニター用ミラーで分岐し、CCDカメラによりその励起分布を結像・観測し、その画像から励起分布を均一にするためにそれぞれのLDの駆動電流を独立に調節する方法が提案されている。この従来技術について以下に説明する。

【0007】この従来例では、図15に示すように、各LD102~107の駆動電流の値を設定する際、まず固体レーザ共振器のミラーをはずした状態で励起を行い、その励起分布が均一になるようにCCDカメラ130で励起分布を観察しながら可変抵抗122~127で調整したのち、再び共振器ミラーを取り付ける方法が記載されている。また、図15に示すように、共振器ミラー120、121を取り付けた状態で、強光分布測定時のみ共振器内に折り返しミラー128を挿入し、この折り返しミラー128を通してレーザロッド101からの蛍光をCCDカメラ130で観察するという方法も提案されている。

【0008】さらに、この従来例では、LDの駆動電源 117を小型化し、配線を簡略化し、さらに各LD10 2~107の駆動電流を独立に調整する方法として、全 てのLDを直列に接続して1つの電源117で駆動し、 各LD102~107に可変抵抗122~127を並列 に接続して4LDに流れる電流値を制御する方法が記載 されている。

# [0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、現在普及している20W以上の高出力動作用のLDチップは発光面が1cm程度の長さを有しているため、後方に設ける光検出器で1cm値すべての光を検出するためには幅の広い検出器が必要になることや、該チップの裏面からでも漏れる光量が大きいために、光検出器の前に減光の

フィルターを設けないと光検出器の出力が飽和してしまうことなどから光検出の構成が複雑になり、コストも高くなるために、過常、高出力動作用し口ではパッケーショ体に光量検出を行う機構を設けていないことが多い。さらにスタックと呼ばれる、LDを狭い間隔で半導体層に対して垂直方向に経層させる構成の場合、裏面に光検出器を設ける十分な場所がないという理由もあり、光検出機能は過常設けられていない。このため高出力LDを用いた高出力の固体レーザ装置の場合、LDの劣化を直接検出することはできなかった。

【0010】また、発光面1cm程度の長さのLD素子が安定して動作できる光出力は20Wから最大で80W程度である。したがってこれ以上高い励起を必要とする高出力レーザ装置の場合にはこのLDをさらに複数個用いる必要がある。例えば、固体レーザ装置からキロワット級のレーザ出力を得るためには1つの固体レーザ探質に対して数十から百個程度、またはそれ以上のLDを同時に対して数十から百個程度、またはそれ以上のLDを同時に用いる場合、個々のLD素子にそれぞれ独立した駆動・でを設けていたのでは電源の数が非常に多くなり、広い設置体検が必要な上に、配線も損難になり運転効率も速に、そこで数個から数十個の複数のLDを1つのグループとして電気的に直列に接続を行い駆動することが通常である。

【ロロ11】このように多数個のLDを直列に駆動する 場合、仮に個々のLDに光検出機能を設け、それによっ てそのうちの特定のLDの出力低下を検出できても、複 数個のLDが電気的に直列に接続されているために、特 定のLDのみの駆動電流を増加させてそのLDのみの出 力低下を補償することはできない。例えば、駆動電流を 増加させて特定のLDの出力を補償する場合、出力低下 を起こしていない他の多くのLDでは出力が当初の値よ り増大するため、そのグループ全体としては励起光出力 が大幅に増大し、固体 レーザ出力も当初設定 した値を大 きく越えて増加したり、他のグループのLDとの励起の バランスが崩れ、逆に固体レーザ出力が低下したり、不 安定になったり、出射ビームの品質が低下したりする恐 れがある。さらに数十個以上の個々のLDに光検出器が 備えた場合、それらを制御するための配線や回路が非常 に複雑になり装置のコストが高くなる。

【 0 0 1 2 】また、従来より知られている方法として、 固体レーザ共振器の外部に取り出されるレーザ発振光量 を検出して、間接的にLDの劣化の度合いを知ることは 可能である。しかし、共振器からの発振光量はLDの劣 化によって低下するばかりでなく、共振器ミラーのアライメントのずれやミラー自身の汚れ、損傷、レーザ経質 の変質や損傷をのコーティング膜の汚れなどによっても 著しく低下し、むしろ頻度としてはLD以外の原因の場合の方が高いために、レーザ発振光の光量からLDの劣 化の度合いを分離して把握することは難しい。

【0013】また、図15及び図15に示した従来の方 法では、レーザ光軸に沿ってあるいはその延長上にCC Dカメラを設置する必要性と、 レーザ発振させると強い レーザ光の影響で蛍光分布が見えなくなるために、蛍光 分布を測定する際に、共振器ミラーを一端はずしたり、 あるいは一時的に共振器内に折り返しらう一を挿入し、 て、周体レーザ装置として発振させないようにする必要。 があり、稼働状態でのLDの劣化検出が出来ないため、 実用性に乏しい。加えて、高いレーザ出力を得る目的で レーザ装置内に複数のレーザロッドが配置されている場 合、レーザ発掘光軸に沿った1つの方向から1台のCC Dカメラで長尺なレーザロッド、あるいは複数のレーザ ロッド内の強光分布を一度に観測することは結像の焦点 距離などから極めて困難であるため、複数のCCDある いは、複数の折り返しミラー、さらにはさまざまな焦点 距離の結像レンズ等が必要になり、光学系が極めて複雑 かつコストが高くなってしまう。

【0014】さらに、従来図で示したように、全てのLDを直列に接続して1つの電源で駆動する場合、直列に接続するLDの数が20~30個を越え、駆動電圧が40Vを越えた場合、逆に電源が非常に大型になる。これは特に駆動電圧の上昇に対応して電源を構成している電子部品が急激に大型になるためであり、搭載するLDの数が多い場合、20~30個のLDを1つのグループとして電源を分けた方が電源全体としては小型になる。また、1つの電源で大電流、高電圧を扱う場合、電子部品の冷却方法や耐久性、信頼性の低下、個々の部品が大型化することによる交換、保守のしつらさも実用的に大きな問題である。さらに加えて可変抵抗で個々のLDへの駆動電流を制御した場合、抵抗における発熱やドリフト、運転効率低下の問題も生じる。

【0015】さらに、本願発明者が実際にレーザ装置を 試作して得た知見として、数十から数百個のLDを用い て1つあるいは数個のレーザロッドを励起する場合、個 々のLDの電流値を変化させても、それが強光分布全体 に及ぼす変化量の割合は小さく、むしろ電源から各LD に供給されている電流値の時間変動や熱変動、リップ ル、検出器の検出揺らぎやノイズの影響による強光の変 動量の方が大きいために、現実には個々のLDの駆動電 流を制御する機構を設けても有効に機能しない。

【0016】さらに、全てのLDを1つの電源で駆動した場合の問題点として、電源に何らかの部品の不良あるいは制御システムの不具合、使用者による誤操作、さらには落雷、停電などの外部的要因によってLDの許容範囲を超える過大電流が流れた場合、全てのLDが同時に一様に破壊されてしまうことになる。

【OD17】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、LD励起固体レーザ装置におけるLDの劣化の度合いを常時、正確に把握することができる信頼性の高いレーザ装置を提供することに

ある。特に、数十個から数百個におよぶ多数個のLDを 搭載した固体レーザ装置において、LDの劣化の度合い とその劣化した部位を正確かつ簡便な構成で把握、検出 できる信頼性の高いレーザ装置を提供することにある。 【OD18】また、本発明の他の目的は、劣化したLD の度合いに応じて固体レーザ雑覧への励起の度合いを補 正、調整するための簡便な方法を提供することにある。 【OD19】

【課題を解決するための手食】上記目的を達成するため、本発明は、励起光を喚収し所定の波長の光を発生あるいは増幅する固体レーザ媒質と、前記励起光を発生もかつ発生した助起光を直接、あるいは光学素子を介して該レーザ練質に導入する半導体レーザ光源とを少なくとも有する固体レーザ装置において、該固体レーザ装置を構成するレーザ共振器内の、該共振器内で発生するレーザ発振光の光軸の近傍かつ光軸を連らない位置に、該固体レーザ経振光の光軸の近傍かつ光軸を連らない位置に配数中で発振光の光軸の近傍かつ光軸を連らない位置に配数された光学的手段と、前記光学的手段に導かれた前記量光を検出する光検出器とからなる構成とすることができる。

【0020】本発明におけるLD劣化検出は、レーザ発 振光ではなくレーザ練質から発せられる蛍光の光量を測定するというものである。蛍光の量は、レーザ練質内で吸収された励起光量に比例するため、波長の変化による吸収量の変化の効果・情報も含まれており、特にLDの場合、ランプと異なり動作温度によって波長が大きく変化するために、単純にLDから出射される励起光量を測定するよりも正確に励起の状況、LDの劣化による波長変化の様子なども知ることができる。

【0021】加えて、蛍光は共振器ミラーのアライメントのずれや汚れなどによって光量がまったく影響を受けない。レーザ線質自身の変質や損傷そのコーティング膜の汚れなどによって低下するが、その度合いはレーザ発 短光の変化に比べれば遠がに小さい。これは蛍光が励起光が照射されているレーザ線質全体から放射されるためで、レーザ発振光よりも局所的な変化の影響を受け難いためである。

【0022】しかしながら、レーザ光と違い強光は指向性が弱く、発生すると伝播しながらすぐに広がって散逸するために、その検出はなるペくレーザ練質に近い位置で行うことが望ましい。固体レーザ練質の外側の周囲は通常金属などで覆われ強光が遮られてしまうが、レーザ発売光の光铀近傍であれば、レーザ練質が光学的に露出しており、かならず強光が観測できる。しかし、光铀近傍でも共振器の外側では共振器のミラーで強光も反射されてしまうために、レーザ共振器内で計測することが望ましい。

【0023】ここで、共振器内で蛍光量を計測する場

合、計測のための光計測器あるいはそこに蛍光を築くための光学的手段、あるいは光検出器そのものがレーザ発 短光の光軸を辿ってしまってはレーザ発振自体が阻害されるために、稼働状態で常時蛍光量を検出するためには 光軸を遮らない程度に近接させる必要がある。

【OD 2 4】本願発明者が実際にレーザ装置を試作して実験的に得た知見として、レーザは質内での励起光の励起分布は、LDとレーザは質との機械的な位置構成が決まれば、その蛍光量あるいはその相対値だけを検出すれば良く、励起分布そのものをCCDカメラで検出する必要はなく、さらに蛍光量を測定すれば励起の分布の状態も常に一定の状態に保たれることがわかった。従って、蛍光量はレーザ光の光軸上で検出する必要はなく、レーザ光に比べて広がりが大きいことを利用して、レーザ光の光軸を適らない程度に離れたところで検出すればよい。また、常に同じ位置で計測することで蛍光量全体との比率は常に一定に保たれるため、励起の全体の状態を正確に知ることが出来る。

【0025】本発明においては、耐記励起光が、耐記レーザ発振光の光铀に対して略直交する方向から導入される構成とすることができる。

【0026】固体レーザ媒質により数多くのLDからの励起光を照射しようという場合、励起光の光軸を固体レーザ媒質でのレーザ発振光の光軸に対して重直に、かつ発振光の光軸に沿って配置するいわゆる側面励起という手法が有効であり、本発明では、LDからの励起光を直接測定するのではなく、固体レーザ媒質からの強光量を測定するため、LDと固体レーザ媒質との位置関係や励起方法に依存せず測定が可能であり、励起光の光軸が固体レーザ媒質でのレーザ発振光の光軸に対して垂直に設定される場合であっても適用することができる。

【0027】また、本発明においては、前記光学的手段が、該固体レーザ媒質から発せられた前記蛍光を反射させるミラーを含み、該ミラーに反射された前記蛍光が、空間伝搬して所定の位置に配設された前記光検出器に入射する構成とすることができる。

【0028】光検出器を直接レーザ共振器内のレーザ発 短光路に近づける場合、光検出器の形状や大きさのために近づけられなかったり、設置位置に制わが生じる場合がある。そこで光検出器をレーザ発短光の光軸から離れたところに設置し、レーザ発短光の光軸にはレーザ媒質からの蛍光が照射され、かつ照射された蛍光を光検出器に向けて反射させる手段を設けることで、直接光検出器をレーザ発短光路に近接させなくとも、蛍光を検出することができる。

【0029】また、本発明においては、前記光学的手段が、前記蛍光の波長において透明な経度を備え、該経度の一端から入射した前記蛍光が、該経度内部を伝播して他端に配設された前記光検出器に入射する構成とするこ

ともできる.

【0030】蛍光は指向性が弱いために、レーザ発振光 路近傍から離れた位置に設置した光検出器まで空間伝播 させた場合、急激に広がってしまい、検出に十分な光量 が取れない場合がある。そこで、蛍光の波長において速 明な媒質を用い、その媒質の一部をレーザ発振光路に近 接させ、また別の一部に媒質内を伝播した蛍光を受光す るように光検出器を配設することにより、蛍光を維質内 に閉じ込めて伝播させ、蛍光が光検出器に到達するまで に著しく拡散・散逸しないようにするというものであ る。その時、レーザ発振光路に近づけるは間の部分を、 薄く或いは細く加工することで狭いレーザ共振器内のレ - ザ光路にも容易に挿入・近接させることができる。さ らにレーザ発振光路に近づける蝶質の部分の形状を蛍光 が効率よく媒質内に導入、光検出器まで効率よく伝播す るように媒質の表面の形状を加工あるいは表面に所定の 反射率を有するコーティングを施してもよい。

【〇〇31】また、本発明においては、前記光学的手段が、前記レーザ発振光の光路の一部において光軸の周囲を取り囲むように形成され、前記光学的手段に設けた開口の端部から入射した前記強光が、外周側端部の所定の位置に配設された前記光検出器に導かれる構成とすることもできる。光軸の周囲を取り囲むように蛍光の波長において透明な傾覚を配設することで、微弱な蛍光まで効果的に収集、取り出し、検出することができる。

【0032】更に、本発明においては、前記開口が、前記レーザ練質の後よりも小さく設定されている構成とすることもできる。レーザ共振器内の発振光光軸の周囲に十分に近接して練質を取り囲むことで、蛍光の検出と同時にレーザ発振光の発振横モードの制御や共振器外からの戻り光の分離を行うことができる。例えば、特願平10-253116号公報にはレーザ光路上に配設してレーザ光のメインビームと迷光成分を分離する非吸収型の円形のアパーチャが記載されているが、このアパーチャの外形側面に近接して光検出器を配設することで、アパーチャ内部を伝播する蛍光も同時に検出することができる。

【0033】また、本発明においては、前記透明な媒質が、ガラスを母材として形成されていることが好ましい。ガラスを母材とすれば安価で形状の加工が容易であり、しかも内部を蛍光が吸収されることなく光検出器まで伝播させることができる。

【〇〇34】また、本発明においては、前記光検出器に 到達する前記量光の光路上に、前記励起光の波長の光を 選択的に演获させるフィルターを備える構成とすること もできる。

【0035】励起の形態によっては、固体レーザ健関から発せられる蛍光を検出するための受光面に励起光が同時に温入する可能性がある。 レーザ発振光軸と励起光の光軸とが平行な場合、 レーザ健関内で吸収されなかった

大量の励起光がレーザ雄賢外へ抜け出て、レーザ雄賢からの強光と同時に光検出器の受光面に温入する可能性がある。

【0036】この場合、例えば励起光の波長が変化し、レーザ媒質の吸収波長からずれた場合、レーザ媒質がの の蛍光量は減少するにもかかわらず、励起光は固体レー ザ媒質での吸収が減るために外に漏れ出す光量が増加 し、全体として光検出器の受光面に達する光の光量は両 者の光量の合計によって大きく変化し、場合によって増加して検出される。したがって蛍光そのものは減少した と言う正しい情報が伝わらない。そこで蛍光が光検出器 の受光面に到達する光路上に、励起光の波長の光を選択 的に減衰するフィルターを備えることで蛍光のみを選択 的に受光することができる。

【0037】また、本発明においては、前記光検出器に 到達する前記蛍光の光路上に、前記固体レーザ線質から 発せられる前記蛍光のうち、レーザ発振に利用されない 蛍光の爆線スペクトルの波長を選択的に透過するフィル ターを備える構成とすることもできる。

【〇〇38】 固体レーザ装置の発掘が始まると光軸に近い位置あるいはその位置からの反射あるいは導波光を検出する光検出器の受光面には、設置位置によっては蛍光のみならず非常に強度の強い発振光の散乱光が照射され、検出器の出力が飽和したり、また飽和を避けるために信号増幅器の利得を下げた場合、発掘前の蛍光強度が十分な特度で測定できない可能性がある。さらに光検出器に入射する発振光が非常に強い場合、光検出器自体を破壊してしまったり性能を劣化させてしまう可能性がある。

【0039】そこで、固体レーザは質から発せられる蛍光がもともと広がりを持っていることを利用し、そのうちのレーザ発振に利用されないスペクトルの波長のみを透過するフィルターを備えることで、レーザは質が発振しても検出器に入射する蛍光の単は大幅に増えないために、光検出器を飽和させたり破壊したりすることがない。

【0040】また、本発明においては、前記半導体レーザ光源が、複数の半導体レーザ素子と、該複数の半導体レーザ素子を所定数のグループに分けて駆動する電源と、前記電源の駆動電流を制御する制御手段とを含み、前記光検出器で検出される前記強光の強度に応じて、前記グループごとの駆動電流が前記制御手段によって調整される構成とすることができる。

【0041】上記従来例で述べたように、固体レーザ装置内で励起用として非常に多くのLDを同時に用いる場合、数個から数十個の複数のLDを1つのグループとして電気的に直列に接続して駆動するのが一般的であるが、単にグループに分けて駆動するだけでなくそれぞれがグループの電源単位に単独で動作できるように電気回路を構成し、それぞれを独立に駆動させたときの固体レ

ーザは質からの蛍光量を測定することで、個々のLDあるいはグループ内のLDの出力、波長などの動作状況を 個別に検出、制御することができ、また故障したLD或 いは故障したLDを含むグループを特定することができる。

【ロロ42】また、故障したLDおよびそれを含む最小限の数のグループのLDだけを交換することで、他の正常なLDおよび含まれるすべてのLDが正常なグループのLDまで交換することなくレーザ装置を復旧させることができるために、LDの交換保守作業が大幅に容易になり、かつ交換するLDが必要最小限で良いために交換時のLD等の部品代も安価になる。

【0043】さらに、LDが故障した場合だけでなく、わずかに劣化した場合に於いてもそれぞれのLDあるいはLDのグループの電気回路を単独に駆動させ、その際快出される固体レーザ解質から発生する蛍光の強度に応じて該各LD光源あるいはそのグループの駆動電流を変化させる制御回路を設けることで、常に固体レーザ媒質への励起状態を一定の状態、あるいは初期的に設定した安定な状態に復帰させることが出来る。また、LDのもともと有する個々の出力や発掘波長のばらつきから生じる励起光の吸収効率の違いについても、そのLDの励起時の蛍光強度から駆動電流を制御することで、実用的に最小限のばらつきの範囲内に補正することが出来る。

【0044】また、個々のLDの駆動電流を独立に制御する必要はなく、20個ぐらいまでの単体LDをグループとして1つの電源で駆動し、その中の個々のLDについては個別に駆動できるような回路構成にはしない。これによって小型で信頼性の高い電源が構成でき、さらに電源の電子部品に不具合があった場合でもそれによるLDの破損を最小限に抑えることが出来る。

【0045】また、本発明は、上記構成の半導体レーザ 励起個体レーザ装置のみならず、該レーザ装置による前 記半導体レーザ光源の劣化状況の診断方法を提供するも のである。

# [0046]

【発明の実施の形態】本発明に係る半導体レーザ励起園体レーザ装置は、その好ましい一実施の形態において、レーザロッドと、励起光を発生する半導体レーザ素子と、レーザ共振器内のレーザ光铀の近傍がつ光軸を速らない位置に設けた反射ミラー、光導波媒質等の光学的手段と、蛍光を検出する光検出器とを少なくとも有し、固体レーザ機質から発生する蛍光の量を光検出手段で検出し、その蛍光量と子め定めた値又は子の測定した値とを比較することによって、半導体レーザ光源の劣化状況を常時診断するものである。

# [0047]

【実施例】上記した本発明の実施の形態についてさらに 詳細に説明すべく、本発明の実施例について図面を参照 して説明する。 【0048】 【実施例1】まず、本発明の第1の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図1を参照して説明する。図1は、本発明の第1の実施例に係るし口励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ媒質内のレーザ発振光光軸に沿ってレロの励起光を照射するいわゆる端面励起の構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0049】図1に示すように、複数個機層された半導体レーザ素子2(例えば、出力40W、発光幅1cmを5素子機層)より出射した励起光4(波長808nm)は、集光光学系3を通して円筒形のNd:YAGレーザロッド1(例えば、Nd波度1.0%at、ロット直径3cm、長さ5cm)の城面1aを通してレーザロッド1内に照射される。相対するレーザロッド1の城面1bには、例えば、励起光808nmに対して反射率95%以上、レーザ発振光波長1064nmに対して0.2%以下の反射率を持つ誘電体多層膜が形成されており、レーザロッド1に吸収されなかった励起光4は端面1bで再度レーザロッド1の内部に反射されるようになっている。

【0050】本実施例の固体レーザ発振器は、レーザロッドの励起光が入射する端面1 a と相対して設けた出力ミラー8(例えば、凹面曲率半径1m)の端面8 a で共振するように反射膜コーティングされて配置されており、レーザ発振光の光軸5を形成している。具体的には、例えば、端面1 a には励起光808 n m に対して透過率95%以上、レーザ発振光波長1064 n m に対して99%以上の反射率を持つ誘電体多層膜が形成され、端面8 a にはレーザ発振光波長1064 n m に対して90%の反射率を持つ誘電体多層膜が形成されている。

【0051】 - 方、Si等を母材とする半導体光検出器7は、その共振器内の光轴5の近傍、かつ光轴を遮らない位置に設置されている。半導体レーザ素子2から照射された励起光4はレーザロッド1内で吸収され、吸収された領域から蛍光6が発生する。蛍光6は四方八方に拡散するが、そのうちの一部の蛍光が、図1に示すようにレーザロッド1の共振器側の場面1bを通して外部に拡散し、半導体光検出器7に到達する。

【0052】螢光6は吸収された領域から方向性なく均一に四方に広がるため、レーザロッド 1 や半導体光検出器 7 の位置などが変化しなければ、半導体光検出器 7 で検出される蛍光章の変化は、レーザロッド 1全体から発生される蛍光章の設量、すなわち励起光 4 の吸収量にほぼ比例する。励起光 4 の吸収量が減る原因としては半導体レーザ素子の劣化による励起光出力の低下が最も代表的なものであるが、他に半導体レーザ素子の冷却機構の不良による波長の変化、さらに度合いとしては少ないが集光光学系3 の汚れや破損、レーザロッド 1 の破損などがある。

【0053】具体的な半導体レーザ素子2の劣化の検出手順としては、半導体レーザ素子2が劣化していない初期の状態に於いて、特定の駆動電流で駆動したときの蛍光量を半導体光検出器7で検出して記録しておき、一定時間軽過後あるいは必要に応じて同じ駆動電流で半導体レーザ素子2を駆動し、そのとき検出される蛍光強度と比較することで半導体レーザ素子2の劣化状況を把握することが出来る。

【ロロ54】このときの半導体レーザ素子2の駆動電流 は、固体レーザが発掘する駆動電流値より低く選ぶと都 合がよい。もちろん固体レーザが発掘している状態でも 蛍光量の検出は可能であるが、固体 レーザが発掘した状 態では単純に蛍光量だけで励起光の吸収の度合いを判断 することは出来ない場合が出てくる。 これは固体レーザ が発掘すると吸収された励起光エネルギーが発掘光とし ても消費されるためで、例えばミラーの汚れやアライメ ントのズレなど固体レーザ共振器に障害があった場合、 吸収された励起エネルギーがレーザ光に変換される割合 が減少し、代わりに強光として放出されるために検出さ れる蛍光の量が上がるが、これは励起光の状態を反映し ていない。半導体レーザ素子2の駆動電流を固体レーザ が発振する駆動電流値より低く選べば、 レーザロッド 1 内に吸収されたエネルギーはほとんど全て蛍光 6に変換 されるために、蛍光強度と励起光4の吸収の度合いは常 に比例すると判断することが出来る。

【0055】また、後述するように、半導体レーザ素子 2あるいは半導体レーザ素子2のグループが複数の独立 した電源あるいは独立して駆動できるように回路が構成 されており、かつそれらを単独で駆動した場合に、それ によって励起された固体レーザ装置が発掘しないような 構成の場合には、それらの半導体レーザ素子2あるいは そのグループを単独に駆動し、特定の電流値に設定して 蛍光強度を測定することで、各半導体レーザ素子2ある いはそのグループの劣化状況を独立に把握することが出 来る。

【0056】 [実施例2] 次に、本発明の第2の実施例に係る半導体レーザ励起圏体レーザ装置について、図2及び図13(d)を参照して説明する。図2は、第2の実施例に係るLD励起圏体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ雑質のレーザ発振光光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発版光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。また、図13(d)は、蛍光を反射するミラーの他の構成を示す断面図である。

【0057】図2に示すように、Nd:YAGレーザロッド10(例えば、Nd濃度の.7%at、ロッド直径5cm、長さ10cm)の長手方向に沿って複数の半導体レーザ素子20a~20h(それぞれ出力40W程度)が配設されており、それより出射された励起光40a~40h(波長809nm)は、光学系30a~30

nを通して整形され該レーザロッド 1 0 に照射される。 【0058】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー8 0、81よりなり、それらのレーザロッド 1 0 に対向した端面80a、81aには固体レーザの発振光(波長1 064 nm)に対して特定の反射率を有する誘電体多層 関が形成されている。具体的には、例えば、端面80a には波長1064 nmに対して99%以上の高反射膜、 81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10によって図中50で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光軸50とレーザロッド10によって図中50で示すレーザ発振光を反射散造しないように、例えば、波長1064 nmに対して反射率0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0059】このレーザ共振器内の光軸50の近傍、かつ光軸を連らない位置に、例えば、波長1064nmに対して97%の反射率を有する反射ミラー71が配設されており、レーザロッド10から発せられた蛍光60を、半導体光検出器70に向けて反射するように角度が調整されている。なお、蛍光60を反射するミラーとして、図13(d)に示すようなパラボラ型ミラー96を用いることもでき、この場合は、装置としては大がかりとなるが、広い範囲の蛍光60を効率よく半導体光検出部70に集光することができ、高感度に蛍光60を検出するシステムに適している。

【0060】 【実施例3】 次に、本発明の第3の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図3を参照して説明する。図3は、第3の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ媒質のレーザ発振光光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0061】図3に示すように、Nd:YAGレーザロッド10(例えば、Nd遊度の.7%et、ロッド直径5cm、長さ10cm)の側面、長手方向に沿ってレーザロッド10を取り囲むように複数の半導体レーザ素子20e~20hが配設されており、それより出射された励起光40e~40h(波長809nm)は光学系30e~30hを通して整形され該レーザロッド10に照射される。

【0062】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッド10に対向した端面80s、81sには固体レーザの発振光(波長1064nm)に対して特定の反射率を有する誘電体多層限が形成されている。具体的には、例えば、端面80sには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81sには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10によって図中50で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光軸とレーザロッド10が接する端

面10 a、10 bには固体レーザ発掘光を反射散逸しないように、例えば、波長1054nmに対して反射率
0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0063】このレーザ共振器内の光軸50の近傍、かつ光軸を連らない位置に波長1064nmに対して透明な鍵質72(例えば、石英ガラス)が配設されており、レーザロッド10から発せられた蛍光60を、半導体光検出器70に向けて反射するように角度が調整された蛍光60は光導波鍵質72のレーザロッド10に対向した面72eを透過し、直進してきた蛍光60に対し约45度の角度を有する面72bで反射され、光導波媒質72内を伝搬し、面72cより出射され、面72cに近接して配置された半導体光検出器70の受光面に達する。

【0064】このように透明な光学波域質72を介して 蛍光60を検出することにより、半導体光検出器70の 受光面を直接レーザの光路に近づける必要がないため、 半導体光検出器70の配置の自由度が高く、例えばレー ザロッド10と共振器ミラー81の間隔が狭く半導体光 検出器70を挿入することが難しい場合でも、小型のは 質72を挿入することで蛍光60を半導体光検出器70 に効率的に導き検出することが出来る。

【0065】【実施例4】次に、本発明の第4の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図4を参照して説明する。図4は、第4の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ雑質のレーザ発掘光光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0066】図4に示すように、整形のNd: YAGレーザスラブ15(例えば、Nd濃度の、7%at、スラブ幅5cm、長さ10cm)の長手方向に沿って複数の半導体レーザ素子20a~20dが配設されており、それより出射された励起光40a~40d(波長809nm)は光学系30a~30dを通して整形され該レーザ結晶に照射される。

【0067】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらの固体レーザスラブ15に対向した場面80a、81aには、例えば、固体レーザの発振光(波長1064nm)に対して特定の反射率を有する誘電体を解散が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザスラブ15によって図中で示すジグザグのレーザ発振光軸51が形成される。レーザ発振光は光軸に対してブリュースター角に傾けられた端面15a、15bを透過し、スラブ内の半導体レーザ素子に励起される端面15dおよび対向する15cで全反射しながら進行する。

【0068】このレーザ共振器内の光铀51の近傍、かつ光铀を速らない位置に波長1064nmに対して透明な誤實72が配設されており、固体レーザスラブ15から発せられた蛍光60を、半導体光検出器70に向けて反射するように角度が調整されている。

【0069】【実施例5】次に、本発明の第5の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図5、図13(a)乃至(c)及び図14を参照して説明する。図5は、第5の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ減質のレーザ発掘光光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。また、図13(a)乃至(c)は、光導波媒質の詳細構造及びパリエーションを模式的に示した図であり、図14は、半導体レーザ励起固体レーザ装置の他の構造を模式的に示した図である。

【0070】図5に示すように、Nd:YAGレーザロッド10(例えば、Nd濃度0,7%at、ロッド直径5 cm、長さ10 cm)の側面、長手方向に沿って、レーザロッド10を取り囲むように複数の半導体レーザ素子20 a~20 nが配設されており、それより出射された励起光40 a~40 n(速長808 nm)は光学系30 a~30 nを通して整形され該レーザロッド10 に照射される。

【0071】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッド10に対向した端面80a、81aには固体レーザの発振光(波長1064nm)に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10によって図中50で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光軸とレーザロッド10が接する端面10a、10bには固体レーザ発販光を反射散逸しないように波長1064nmに対して反射率0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0072】このレーザ共振器内の光触50の近傍、かつ光触を速らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質73が配設されている。媒質73は光触50の周囲を取り囲んで光触を中心に回転対称形状を有しており、その側面外部に半導体光検出器70が近接されている。媒質73の光触に対向した面には図に示すように三角形状の突起が形成されており、レーザロッド10より発せられた蛍光60がその面73aを通して媒質73内に導入され、内部で反射されながら外側へ伝搬され、最終的に半導体光検出器70の受光面に達する。

【0073】より具体的には、図13(a)に示すように、光導波媒質73は、レーザ光90が通過する中心部分に開口を有する円盤状に形成され、開口部近傍には所

定の傾斜角を有する蛍光入射端面73 a が設けられ、外周部には半導体光検出器70以外の領域に金属又は誘電体膜等からなる全反射膜93が設けられており、端面73 a から入射した蛍光5.0はは質73の外周部に向かって放射状に伝擔し、外周部の全反射膜93によって反射されて最終的に半導体光検出器70に入射する。

【0074】なお、光築波域質の形状として円盤状に限らず、多角形形状や特円形状等であってもよい。例えば、図13(b)に示す台形の場合は、蛍光入射端面94mから入射した蛍光60が光築波域質93の外周部に向かって伝搬し、半導体光快出器70が配置されるに以外の外周に設けた全反射限93で反射して最終的に半導体光快出器70に入射する。また、図13(c)に示す特円形状の場合は、光導波域質95の開口部の中心及びレーザ光铀50を特円の第1焦点に配置し、半導体光快出器70を第2焦点に配置することによって全反射限93で反射される全ての蛍光60を半導体光快出器70で特出することができる。また上記構造において、光導波域質の半導体光検出器70に対向する面に無反射限97を設けることによって蛍光60の反射を抑え、蛍光60を効率よく半導体光検出器70に導くことも可能となる

【0075】このように遠明な謀質73を光軸の周囲を取り囲むように配置することで謀質73内へ築入できる 蛍光60の量が増加し、半導体光検出器70の受光面に 速する蛍光60の量を増やすことが出来る。また、半導体光検出器70の受光面を直接レーザの光路に近づける 必要がないため、半導体光検出器70の配置の自由度が 高く、例えばレーザロッド10と共振器ミラー81の間 隔が狭く半導体光検出器70を挿入することが難しい場合でも、薄型の謀質73を挿入することで半導体光検出器70に蛍光60を導き、検出することが出来る。

【ロロ75】なお、図14に示すように、半築体光検出器70は円盤状の様質73の周囲を取り囲むように複数並べて形成しても良く、この複数の半築体光検出器70からの出力を比較することによって、レーザ発光の軸対象性を判断することができ、また、劣化の詳細な部位の特定を行うこともできる。

【0077】 [実施例6] 次に、本発明の第6の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図6を参照して説明する。図6は、第6の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ越質のレーザ発掘光光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0078】図5に示すように、Nd:YAGレーザロッド10(例えば、Nd適度の.7%et、ロッド直径5cm、長さ10cm)の側面、長手方向に沿ってレーザロッド10を取り囲むように複数の半導体レーザ素子20e~20hが配設されており、それより出射された

励起光40a~40h(波長808nm)は光学系30a~30hを通して整形され該レーザロッドに照射される。

【0079】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッドに対向した端面80a、81aには固体レーザの発振光(波長1064nm)に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには波長1054nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10によって図中50で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光触50とレーザロッド10が接する端面10a、10bには固体レーザ発振光を反射散逸しないように、例えば、波長1064nmに対して反射率0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0080】このレーザ共振器内の光軸50の近傍、かつ光軸を連らない位置に波長1054nmに対して透明な謀関74が配設されている。媒質74は光軸50の周囲を取り囲むように光軸を中心に回転対称形状を有しており、その外部に半導体光検出器70が近接されている。媒質74の光軸に対向した面には図に示すように三角形状の突起が形成されており、レーザロッド10より発せられた蛍光50がその面740を通して回折あるいは反射されて経質74内部へ伝挽され、最終的に半導体光検出器70の受光面に達する。

【0081】このように透明な雑質74を光軸の周囲を取り囲むように配置することで練質内へ導入できる蛍光50の量が増加し、半導体光検出器70の受光面に達する蛍光50の量を増やすことが出来る。また、半導体光検出器70の受光面を直接レーザの光路に近づける必要がないため、半導体光検出器70の配置の自由度が高く、例えばレーザロッド10と共振器ミラー81の間隔が狭く半導体光検出器70を挿入することが難しい場合でも、津型の離質74を挿入することで蛍光50を検出することが出来る。

【0082】さらに経質74の光軸が通過する穴の直径は3.5mm程度で、レーザロッド10の外径5mmよりも小さく設定されている。このためレーザ発振時にはピーム広がり角の大きいあるいはピーム径の広いピーム品質の悪い成分は減質74を通過する際に大きな光学的な損失を受け、発振が阻害されるために最終的にミラー81より出射されるレーザ光90の品質を高めることが出来る。蛍光強度の検出と同時にレーザピーム品質の改善も同時に実現することができる。

【0083】 [実施例7] 次に、本発明の第7の実施例に係る半導体レーザ励起圏体レーザ装置について、図7を参照して説明する。図7は、第7の実施例に係るLD励起圏体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ線質のレーザ発振光光軸に沿ってLDの励起光を

照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0084】図7に示すように、Nd:YAGレーザロッド10(例えば、Nd:)歳日の.7% et、ロッド直径5cm、長さ10cm)の側面、長手方向に沿ってレーザロッド10を取り囲むように複数の半導体レーザ未子20e~20hが配設されており、それより出射された励起光40e~40h(波長808nm)は光学系30e~30hを通して整形され該レーザロッド10に照射

【0085】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッドに対向した端面80g、81gには、固体レーザの発振光(波長1054nm)に対して特定の反射率を有する誘電体外層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80gには波長1054nmに対して99%以上の高反射膜、81gには同じく80%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10によって図中50で示すレーザ発振光軸が形成される。また、レーザ光軸50とレーザロッド10が接する端面10g、10㎏には固体レーザ発振光を反射散逸しないように、例えば、波長1064nmに対して反射率0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0086】このレーザ共振器内の光軸50の近傍、かつ光軸を連らない位置に波長1064nmに対して透明な謀實72、74がそれぞれミラー80、81に近接して配設されている。謀實72は、レーザロッド10の端面10aより発せられる蛍光60aを謀實内を伝挽させ、近接させた光検出器70aに墜くように配置されており、一方、謀質74は光軸50の周囲を取り囲むように光軸を中心に回転対称形状を有しており、その外部に半導体光検出器70bが近接されている。謀實74の光軸に対向した面には図に示すように三角形状の突起が形成されて対り、レーザロッド10より発せられた蛍光60bがその面で回折あるいは反射されて謀質74内部へ伝挽され、最終的に半導体光検出器70bの受光面に達

【0087】レーザロッド10が長尺で半導体レーザ素子の配列の数が多くなった場合、蛍光は指向性が少ないために半導体光検出器からより違いLDあるいはレーザロッド10の励起領域の蛍光が散逸してしまうが、このようにレーザロッド10を挟んで両端面側に半導体光検出器を配置することで、一方の検出器から遠い半導体レーザ素子あるいは励起領域の情報もより正確に知ることが出来る。

【0088】【実施例8】次に、本発明の第8の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図8乃至図10を参照して説明する。図8は、第8の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ線質のレーザ発振光光軸に沿ってLD

の励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光 触方向に沿った方向の断面の様子を示している。また、 図 9は、励起光速光フィルターの通過特性を示す図であ り、図 1 0 は、発振に寄与しない波長成分のみを取り出 す狭帯域速過フィルターの速過特性を示す図である。

【0089】図8に示すように、複数個核層された半導体レーザ素子2(例えば、出力40W、発光幅1cmを5素子核層)より出射した励起光4(波長808nm)は集光光学系3を通して円筒形のNd: YAGレーザロッド1(例えば、Nd濃度0.8%et、ロッド直径3cm、長さ5cm)の端面1eを通してレーザロッド1内に照射される。

【0090】相対するレーザロッド1の端面1 bには、例えば、励起光808nmに対して反射率95%以上、レーザ発振光波長1054nmに対して0.2%以下の反射率を持つ誘電体多層膜が形成されており、レーザロッド1に吸収されなかった励起光は端面1 bで再度反射されレーザロッド1内に戻されるようになっている。

【0091】本実施例の固体レーザ発掘器はレーザロッド1の励起光4が入射する端面1aと相対して設けた出力ミラー8の端面8aで共振するように反射限コーティングされて配置されており、レーザ発振光の光軸5を形成している。具体的には、例えば、端面1aには励起光808nmに対して透過率95%以上、レーザ発振光波長1064nmに対して99%以上の反射率を持つ誘電体多層限が形成されている。また同じく端面8aにはレーザ発振光波長1064nmに対して90%の反射率を持つ誘電体多層限が形成されている。

【0092】このレーザ共振器内の光軸5の近傍、かつ光軸を遮らない位置に波長1064nmに対して途明な媒質72が配設されている。媒質72は光軸5の周囲を取り囲むように光軸を中心に回転対称形状を有しており、その外部に半導体光検出器7が近接されている。媒質72の光軸に対向した面には図に示すように三角形状の突起が形成されており、レーザロッド1より発せられた蛍光6がその面で回折あるいは反射されて媒質72内部へ伝搬され、最終的に半導体光検出器7の受光面に達する。

【0093】このように透明な媒質 73を光軸5の周囲を取り囲むように配置することで媒質 73内へ導入できる蛍光6の量が増加し、半導体光検出器 7の受光面に達する蛍光6の量を増やすことが出来る。また、半導体光検出器 7の受光面を直接レーザの光路に近つける必要がないため、半導体光検出器 7の配置の自由度が高く、例えばレーザロッド1と共振器ミラー8の間隔が狭く半導体光検出器 7を挿入することが難しい場合でも、薄型の媒質 72を挿入することで蛍光6を検出することが出来る。

【ロロ94】さらに、媒質73の側面と半峰体光検出器 7との間には、励起光4の波長を吸収し、レーザロッド

1より発せられる蛍光5のみを透過する励起光遮光フィ ルター(例えば、HOYA RM100)75と、蛍光 5のうちレーザ発振に寄与しない波長成分のみを透過す る狭帯域透過フィルター (干渉フィルター) 7.6が挿入 されており、半導体光検出器でには蛍光5のうちレーザ 発振に寄与しない波長の光のみが到達し検出される。こ のように2枚のフィルターを備えることにより、励起光 そのものではなく励起光を吸収することによって発生す る蛍光の量を正確に信頼性よく計測することが出来る。 【0095】図9は、励起光をカットし、蛍光のみを透 過する励起光速光フィルターフラの透過特性の一例を示 した図である。図からわかるように、励起光808nm 近傍では遠過率が5%未満と低く、逆に蛍光の波長10 54nm近傍では高い遠過率を有する。このような特性 のフィルターとしては、例えばHOYA製のRB5ある いはRM100があげられる。また吸収型のフィルター ではなく、同様の透過性を有する誘電体多層膜でもよ

【0096】また、図10は、レーザロッド1より発せられる蛍光成分のうち、発掘に寄与しない波長成分のみを取り出す狭帯域透過フィルター76の透過特性の一例を示した図である。図からわかるように、蛍光成分のうち946nm近傍の光を透過し、主に発照に寄与する1064nm近傍の光を透過しない。このような特性は干渉フィルターを用いることで容易に実現することができる。もちろん干渉型フィルターの代わりに、誘電体多層膜によるパンドパスフィルターでも構わない。更に透過波長は、Nd:YAGの他の発光スペクトルである1310nm近傍にしても構わない。

【0097】また、本実施例では光導波模質73と半導体光検出器7との間に励起光速光フィルター75及び狭帯域透過フィルター75を設ける構成について記載したが、光端波媒質73自体を特定の波長の光を透過又は吸収する材料で形成し、フィルターの機能を兼ね備えることも可能である。また、狭帯域透過フィルター76の帯域を蛍光の波長近傍で細かく分割し、レーザロッド1の劣化に応じて変化する蛍光波長のずれを検出することも可能である。

【0098】【実施例9】次に、本発明の第9の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図11を参照して説明する。図11は、第9の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、複数個直列に配置されたレーザ解質のレーザ発振光光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面を示している。

【0099】図11に示すように、長手方向に配列された3本のNd:YAGレーザロッド10、11、12 (例えば、Nd濃度0.7%at、ロッド直径5cm、 各長さ10cm)の側面、長手方向に沿って同じく複数 .の半導体レーザ素子20e~20h、21e~21h、22e~22hが配設されており、それより出射された励起光40e~40h、41e~41h、42e~42h(波長808nm)はそれぞれ光学系30e~30h、31e~31h、32e~32hを通して整形され該レーザロッド10、11、12に照射される。

[0100] 固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッドに対向した端面80 a、81 aには固体レーザの発掘光(波長1064 nm)に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80 aには波長1064 nmに対して99%以上の高反射限、81 aには同じく50%の部分反射関が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド10~12によって図中51で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光触51と各レーザロッド10~12が接する端面10 a~12 a、10 b~12 bには、例えば、固体レーザ発振光を反射散逸しないように波長1064 nmに対して反射率0、2%以下の反射防止限が形成されている。

【0101】このレーザ共振器内の光触51の近傍、かつ光触を連らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質72e~72dが配設されている。各媒質は光铀51の周囲を取り囲むように光铀を中心に回転対称形状を有しており、レーザロッド10、11、12の各端面より発せられる蛍光60e~62e、60b~62bを媒質内を伝搬させ近接させた光検出器70e~70dに達くように配置されている。各媒質の光軸に対向した面には図に示すように三角形状の突起が形成されており、各レーザロッドより発せられた蛍光がその面で回折あるいは反射されて媒質内部へ伝搬され、最終的に半導体光検出器の受光面に達する。

【0102】具体的には繋買72aはレーザロッド10の端面10aを通して発生される強光50aを検出し、 媒関72bはレーザロッド10の端面10bあるいはレーザロッド11の端面11aを通して発せられる敏光50bあるいは51aを検出し、媒質72cはレーザロッド11の端面11bあるいはレーザロッド12の端面12eを通して発せられる蛍光51bあるいは52aを検出し、建質72dはレーザロッド12の端面12bを通して発せられる蛍光52bを検出するように配設されている。

【 0 1 0 3】 レーザロッドが長尺で半導体レーザの配列の数が多くなった場合、蛍光は指向性が少ないために検出器からより違いLDあるいはレーザロッドの励起領域の蛍光が散逸してしまうが、このようにレーザロッド 1 0~1 2を挟んで両端面側に半導体光検出器を配置することで、一方の検出器から違いLDあるいは励起領域の情報もより正確に知ることが出来る。

【ロ1ロ4】さらに各媒質728~72dと半導体光検

出器70a~70dとの間には、半導体レーザの励起光の波長を吸収、あるいは反射し、レーザロッドより発せられる敏光のみを透過する励起光速光フィルター75a~75dと、蛍光のうちレーザ発振に寄与しない波長成分のみを透過する狭帯域透過フィルター76a~76dが挿入されており、半導体光検出器には蛍光のうちレーザ発振に寄与しない波長の光のみが到速し検出される。このように2枚のフィルターを備えることにより、励起光でのものではなく励起光を吸収することによって発生する蛍光の量を正確に信頼性よく計測することが出来る。

【0105】 [実施例10] 次に、本発明の第10の実施例に係る半導体レーザ励起固体レーザ装置について、図12を参照して説明する。図12は、第10の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示した図であり、レーザ機関のレーザ発振光光軸に沿ってLDの励起光を照射される構成において、レーザ発振光の光軸方向に沿った方向の断面の様子を示している。

【0106】図12に示すように、長手方向に配列された2のNd: YAGレーザロッド11、12(例えば、Nd濃度1、0%at、ロッド直径5cm、長さ10cm)の長手方向に沿って同じく複数の半導体レーザ素子25a~25h、26a~25hが配設されており、それより出射された励起光40a~40h、41a~41h(波長809nm)は光学系30a~30h、31a~31hを通して整形され該レーザロッドに照射される。

【0107】固体レーザ共振器は2枚の共振器ミラー80、81よりなり、それらのレーザロッドに対向した端面80a、81aには固体レーザの発振光(波長1064nm)に対して特定の反射率を有する誘電体多層膜が形成されている。具体的には、例えば、端面80aには、波長1064nmに対して99%以上の高反射膜、81aには同じく75%の部分反射膜が形成されている。これら2枚のミラー80、81および固体レーザロッド11、12によって図中51で示すレーザ発振光軸が形成される。またレーザ光軸51と各レーザロッド11、12が接する端面11a、11b、12a、12bには固体レーザ発振光を反射散逸しないように波長1064nmに対して反射率0、2%以下の反射防止膜が形成されている。

【0108】このレーザ共振器内の光軸51の近傍、かつ光軸を速らない位置に波長1064nmに対して透明な媒質72e~72cが配設されている。各媒質72e~72cは光軸5の周囲を取り囲むように光軸を中心に回転対称形状を有しており、その外部に半築体光検出器70e~70cが近接されている。媒質72e~72cの光軸に対向した面には図に示すように三角形状の実起が形成されており、レーザロッド11、12より発せられた蛍光60e、60b、61e、61bがその面で回

折あるいは反射されて媒質内部へ伝搬され、最終的に半 基体光線出器の受光面に達する。

【0109】ロッドが長尺で半導体レーザの配列の数が多くなった場合、強光は指向性が少ないために検出器からより違いしつあるいはロッドの励起領域の強光が散逸してしまうが、このようにレーザロッド11、12を挟んで両端面側に半導体光検出器を配置することで、一方の検出器から違い半導体レーザあるいは励起領域の情報もより正確に知ることが出来る。

【0110】さらには質728~72cと光検出器708~70cとの間には、励起光408~40h、418~41hの波長を吸収、あるいは反射し、レーザロッドより発せられる蛍光のみを透過する励起光速光フィルター758~75cと、蛍光のうちレーザ発振に寄与しない波長成分のみを透過する狭帯域透過フィルター758~76cが挿入されており、半導体光検出器708~70cには蛍光のうちレーザ発振に寄与しない波長の光のみが到速検出される。このように2枚のフィルターを備えることにより、LDからの励起光の吸収状況を正確に計測することが出来る。

【0111】そして、図に示すように半導体レーザ素子を2個ずつ直列に接続しそれぞれ独立の電源25a~26dで駆動する。それらの電源には電流値を外部から制御するための制御信号がインターフェース91a~91dから供給される。さらにインターフェースは上位の制御ホスト92によって制御・監視・記録される。

【0112】次に、基本的な制御の流れの一例を説明する。制御ホスト92からの指令によってインターフェース91aを介して電源25eから電流25アンペアが半導体レーザ素子20a、20bに供給される。このとき電源25a以外の他の電源は休止している。半導体レーザ素子20a、及び20bからの励起光40a、40bは光学系30a、30bで整形された後、レーザロッド11に照射される。半導体レーザ光はレーザロッド11に照射される。半導体レーザ光はレーザロッド11 aに吸収され敏光60aを発する。この敏光はその発生した位置から最も近い蛍光快出用の透明媒質72aに依据し、媒質72a内を伝播した後、励起光を除去するための励起光遮光フィルター75aと螢光成分のうち、実際にレーザ発短に寄与しない成分のみを透過するフィルター76aを透過した後、半導体光検出器70aに到達し検出される。

【0113】このとき、半導体レーザ素子20a、20bのみ駆動されているため、半導体光検出器70aにより検出される蛍光量は半導体レーザ素子20a、20bからの励起によって発生したものである。従って検出される蛍光量は、半導体レーザ素子20a、20bの励起光の吸収量に比例し、言い換えればこれら半導体レーザ素子の出力光の給量及びその波長を反映した値である。【0114】次に、同様に制御ホスト92からの指令によりインターフェース91bを通して電源25bより半

導体レーザ素子20c、20dに通電を行う。このとき 発生する蛍光60bは最も距離の近い72bを通して半 導体光検出器70bで検出される。このときの駆動電流 は固体レーザ装置が発掘しない値に選択する必要があ ス

【0115】このようにすべての駆動電源25a~25 d を順に単独に駆動し、その時発生する蛍光強度を最寄 りの半導体光検出器で検出し、制御ホスト92に記録し ておく。 基準となる状態、たとえば、 これらの半導体レ - ザ素子が新品でまったく劣化していない状態で特定の 電流値、たとえば 25アンペアを通電し、このときの蛍 光量を制御ホスト92のメモリーに記憶しておく。次に - 定時間軽過後、あるいは固体レーザ出力に異常が発生 した時点で、再度すべての駆動電源を同様に単独で駆動 し、そのときに発生する蛍光強度を全く同様の経路で半 **導体光検出器により検出する。そして、それらの値を元** の値と比較することで各半導体レーザ素子の劣化の具合 を個別に検出することが可能である。たとえば蛍光の量 が使用開始時の70%以下まで低下した場合、その電源 で駆動している半導体 レーザ素子が劣化したと判断し交 換するように決めておけばよい。

【O115】なお、以上の実施例において、Nd:YAGをレーザ練質の例としてあげたが、他のいかなるレーザ発掘元素、例えば、Yb、Ho、Tm、Cr、Tiを含むものでもよいし、母材としても他にYLFやYVO4、GGG、GSGGのような結晶でもよく、ガラス、セラミックのような非晶質のものでもよい。

【ロ117】また、光導波媒質の材料としてはガラスを 例としてあげたが、励起光に対して高い透過率を有する ものであればよい。特に、鉛を添加した高屈折率のガラ スを用いれば、導波板内を伝搬する励起光が全反射によ り効率的に伝搬できる。また、屋折率の高い透明な材料 として、サファイアやレーザ元素を含まないY AGなど の結晶材料でもよい。また、光導波媒質の形状として穴 のあいた円盤状形状、台形、楕円形やパラボラ形状を挙 げたが、他のいかなる形状でもよく、レーザ媒質から発 生した蛍光を光検出器まで伝搬させるものであれば、す べて本特許の請求の範囲に含められる。また形状や護質 としてはなるべく伝搬の途中で弱めないようなものであ ればよく、さらに集めるような形状であれば理想的であ る。プラスチックのような樹脂でも良いので、光ファイ バーでも良い。レーザロッドの径は実施例では直径 5m mを用いたが、他のサイズでもよく、必要とされるレー **ザ装置の構成上最適な径と長さが選ばれる。また励起に** 用いるLDの発掘波長も808nm以外でもよく、レー **ザ結晶や励起分布の構成を考慮して最適な波長が選ばれ** 

【0118】半導体レーザ素子としては、例えば米国S DL社のSDL3470Sを用いることができ、他に米 国オプトパワー社のOPC-AD20-MMM-CLで もよいし、フランスTomson-CSF社のTH-C 1720-Pでもよい。また、半導体レーザ素子も子め アレイ状に4個並べたフランスTomson-CSF社 のTH-C1720-R(4)でもよい。また半導体レーザ素子の出力は1cmあたり20W以下であればよい から30W用でも40W用でもよく、この場合、定格出 カの半分以下の出力で使用することから半導体レーザ素 子の寿命を3倍から9倍程度まで長くすることが出来、 固体レーザ装置の信頼性を向上できる。

【0119】また、以上の実施例では励起光の波長の光を演奏する励起光遮光フィルターと発掘に寄与しない固体レーザ健質の蛍光の凝熱波長のみを選択的に透過する狭帯域透過フィルターをベアで使用したが、励起構成の関係で励起光が半導体光検出器に到透しない場合には、耐者のフィルターを省略しても良いし、また固体レーザロッドの蛍光の輝線波長のみを選択的に透過するフィルターの非透過波長帯が励起光の波長まで達している場合には、同じく後者のフィルターだけで励起光が透過しないたのに前者のフィルターを省略しても良い。半導体光検出器としてSiの例を挙げたが他にGeでもGaAsでもInGaAsでももの半導体材料でも良い。蛍光の波長に合わせ最も感度良く検出できる材料が選択される。

【ロ120】また、励起構成の関係で励起光が半導体光検出器に到達しない場合で、かつ固体レーザが発振しても発振光によって光検出器が性能を劣化させないのであれば、いずれのフィルターも省略してもよい。さらにその代わりに、発振光で光検出器が劣化しないように、すべての光を退棄させるような、たとえばNDフィルターを挿入しても良いし、拡散板を挿入しても良い。

# [0121]

【発明の効果】以上説明したように、半導体レーザからの励起光をレーザロッドで吸収し、増幅する半導体レーザ励起固体レーザ装置において、共振器内の光軸近傍かつ光軸を連らない位置に、反射ミラーや光導波線質等を設けてレーザロッドから発せられる強光を半導体光検出器に導くことによって、励起状態を正確に把握することができ、励起用半導体レーザの状態、寿命をレーザ装置を稼働した状態で計測・管理することができる。

【ロ122】また、本発明では、半導体レーザからの励起光を直接測定するのではなく、レーザロッドからの蛍光を測定するため、半導体レーザとレーザロッドとの位置関係や励起方法に依存せず、励起光とレーザ光の光軸が一致する構成、光軸が直交する構成のいずれに対しても適用することができる。

【 0 1 2 3】また、本発明では、蛍光を測定する半導体 光検出器は共振器内やレーザ光铀近傍にしなくてもよ く、反射ミラーや光導波線質により等けばよいため、レ ーザロッドと共振器ミラーとの間隔が狭い場合であって も確実に蛍光を検出することができる。 【ロ124】また、光築波螺質を光铀の周囲を取りまくようにドーナツ状に形成し、かつ光築波螺質内側の開口経をレーザロッドの経よりも小さくすることによって、広がり角の大きいビームの発振を抑制することができ、蛍光強度の検出と同時にレーザビーム品質の改善も実現することができる。

【0125】また、本発明では、半導体光検出器の前段に励起光遮光フィルタや狭帯域透過フィルタを設置することによって、励起光の退入を防ぎ、レーザ発掘に寄与しなる蛍光のみを検出することができるため、励起光の吸収状況を正確に計測することができる。

【 0 1 2 6】更に、本発明では、複数の半導体レーザ素子を複数のグループに分割し、各々のグループに対して 半導体レーザ素子を駆動する電源を個別に設け、その電源をホストの指令により制御することによって、半導体 レーザ素子の劣化状態を個別に診断することが可能となる。

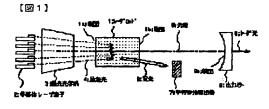
### 【図面の簡単な説明】

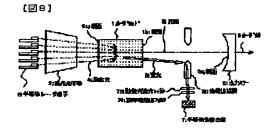
- 【図1】本発明の第1の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。
- 【図2】本発明の第2の実施例に係るしD励起固体レーザ装置の標準を模式的に示す図である。
- 【図3】本発明の第3の実施例に係る L D励起固体 レーザ装置の構造を模式的に示す図である。
- 【図4】本発明の第4の実施例に係るLD励起固体レー ザ装置の構造を模式的に示す図である。
- 【図5】 本発明の第5の実施例に係る L D励起固体 レーザ装置の構造を模式的に示す図である。
- 【図6】本発明の第6の実施例に係る L D励起固体 レーザ装置の構造を模式的に示す図である。
- 【図7】本発明の第7の実施例に係る L D励起圏体 レーザ装置の構造を模式的に示す図である。
- 【図8】本発明の第8の実施例に係るLD励起固体レー ザ装置の構造を模式的に示す図である。
- 【図9】励起光の波長を遮断するフィルターの特性を表わしたものである。
- 【図10】レーザ発振に利用されない趣味スペクトルの 波長のみを透過するフィルターの特性を表わしたもので \*\*\*
- 【図11】本発明の第9の実施例に係る LD励起固体レーザ装置の構造を模式的に示す図である。
- 【図12】本発明の第10の実施例に係るLD励起固体 レーザ装置の構造を模式的に示す図である。
- 【図13】本発明のLD励起固体レーザ装置の他の構造 を示す図であり、(a) 乃至(c) は光導波線質の他の 構造、(d) は反射ミラーの他の構造を示す図である。
- 【図14】本発明の第5の実施例に係るLD励起固体レーザ装置の他の構造を模式的に示す図である。
- 【図15】従来のLD励起固体レーザ装置の構造を示す 図である。

【図 1 5】従来のLD励起固体レーザ装置の構造を示す 図である。

## 【符号の説明】

- 1 レーザロッド
- 1 a、1 b レーザロッド端面
- 2 半導体レーザ素子
- 3 集光光学系
- 4 励起光
- 5 光軸
- 6 蛍光
- 7 光検出器
- 8 ミラ-
- 8 a ミラー端面
- 9 レーザ光
- 10 レーザロッド
- 10a、10b レーザロッド端面
- 15 レーザロッドスラブ
- 15a、15b ブリュースターカット面。
- 15c、15d 全反射端面
- 20a~20h、21a~21h、22a~22h 半
- 導体レーザ素子
- 25a~25d、26a~26d 直流電源
- 30e~30h、31e~31h、32e~32h 光 学系
- 40a~40h、41a~41h、42a~42h 励起光
- 50 レーザ光軸
- $6\,\,0,\;\,6\,\,0\,\,e,\;\,6\,\,0\,\,b,\;\,6\,\,1\,\,e,\;\,6\,\,1\,\,b,\;\,6\,\,2\,\,e,\;\,6\,\,2$
- b 蛍光





- 70、70a~70d 半導体光検出器
- 7 1 反射ミラー
- 72、72e~72d、73、74、94、95 光導波線質
- 72a、72c 低反射コーティング端面
- 726 全反射端面
- 73a、74a、94a、95a 蛍光入射端面
- **75、75e~75d 励起光速光フィルター**
- 76、76a~76d 狭帯域透過フィルター
- 80 共振器ミラー
- 80a ミラー端面
- 81 共振器ミラー
- 81a ミラー端面
- 90 レーザ光
- 91a~91d インターフェース
- 92 制御ホスト装置
- 93 全反射膜
- 96 パラボラ型ミラー
- 97 無反射限
- 101 レーザロッド
- 102~107 励起用半導体レーザ素子
- 117 電源
- 120 共振器ミラー(全反射)
- 121 共振器ミラー(部分反射)
- 122~127 可変抵抗
- 128 折り返しミラー
- 129 集光レンズ
- 130 CCDby5
- 131 制御回路

[図2]

